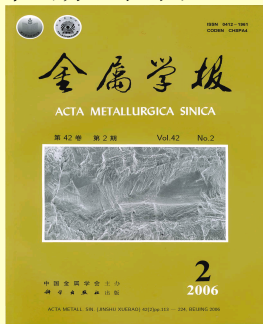


## 本期封面



2006年2

栏目：2

DOI:

论文题目： 老化对Sn-Ag-Cu焊料/Ni-P镀层界面结构和剪切强度的影响

作者姓名： 唐兴勇, 王珺, 谷博, 俞宏坤, 肖斐

工作单位： 复旦大学材料科学系

通信作者： 俞宏坤

通信作者Email: [hkyu@fudan.edu.cn](mailto:hkyu@fudan.edu.cn)

文章摘要： 对Sn-3.5Ag-0.7Cu/Ni-P界面上的焊点进行了150℃固相老化和250℃液相回流老化实验。两种条件下焊料体内和界面处金属间化合物的成分、长大速率及形貌均有较大差异。在液相回流条件下金属间化合物长大更快，对焊点的可靠性有较大的影响。延长固相老化时间，焊点内生成大尺寸的Ag<sub>3</sub>Sn相；高温液相回流有Ni<sub>3</sub>P层生成，降低焊点的焊接强度。

关键词： Sn-Ag-Cu焊料； Ni-P镀层； 高温老化

分类号： TG425.1, TN604

关闭